

LEAD FREE SOLDER PASTE

BZ(L) スタンダードタイプ
はんだボールを
極限まで低減しました!!**Fine Solder**

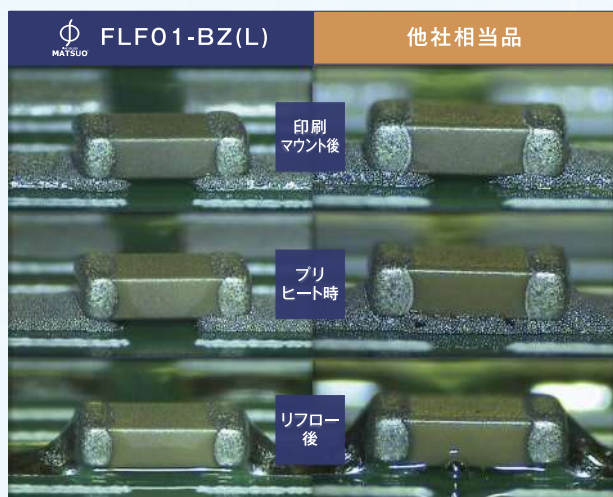
Product Features 製品特性

■ はんだボールを大幅に低減

独自のフラックス技術によりプリヒート時のスランプ(部品下やランド外への流れ出し)を抑制することでのはんだボールの発生を削減することが可能になりました。

■ 高濡れ性で様々な母材に対応

独自の活性剤技術によって銅母材のみならず酸化膜の強固なニッケルや濡れ難い(馴染み難い)亜鉛を含む黄銅にもしっかりと濡れ広がり接合できます。



■ 温度プロファイル条件

高温ロングプリヒートプロファイル (200℃2min)

項 目	FLF01-BZ(L)	試験規格
合金組成	Sn96.5%-Ag3.0%-Cu0.5%	JIS Z3282
固相線温度	約217℃	JIS Z3282
液相線温度	約219℃	JIS Z3282
はんだ粉末サイズ	20~38μm(Type4)	JIS Z3284(J-STD-005)
フラックス含有量	11.50%	JIS Z3197
ハライド含有量	0.05%	JIS Z3197
粘度特性	190Pa·s	JIS Z3284
チクソトロピー指数	0.55	JIS Z3284
銅板腐食試験	合格	JIS Z3197
絶縁抵抗試験(85℃ 85%RH 168hr)	5.0×10 ⁸ Ω以上	JIS Z3197
マイグレーション試験(85℃ 85%RH 1,000hr)	異常なし	JIS Z3197
広がり率	88%	JIS Z3197

